

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成 25 年 4 月 30 日現在

機関番号:14401
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2010~2012
課題番号:22540506
研究課題名(和文)
低エネルギーインジウムイオンの照射による新規反応固体触媒の開発と触媒特性の評価
研究課題名(英文)
Low energy indium ion beam injection for the development of novel catalysts
研究代表者
吉村 智(YOSHIMURA SATORU)
大阪大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:40294029

研究成果の概要(和文):近年、化学分野においてインジウムとケイ素の相互作用により発現す る触媒効果が注目されている。そこで我々は、酸化ケイ素基板へインジウムイオンを注入する 実験を行った。そして、インジウム注入酸化ケイ素基板がベンズヒドロールとアセチルアセト ン間の化学反応を促進する触媒として機能することを発見した。次に、触媒効果のイオンエネ ルギーおよびイオンドース量への依存性を調べた。その結果、触媒効果の発現に最適なエネル ギーとドースの組み合わせが存在することが明らかになった。

研究成果の概要(英文): Chemical substances that contain indium (In) and silicon (Si) in close proximity are known to catalyze certain organic chemical reactions. We have demonstrated that In implanted SiO₂ thin films, formed under some specific conditions, contain In atoms on or near the substrate surface in close proximity with Si atoms and catalyze a reaction of benzhydrol with acetylacetone. In this study, dependence of the catalytic ability of an In implanted SiO₂ thin film on the ion incident energy and dose for the In ion implantation process has been examined. It has been shown that a right combination of ion energy and ion dose must be selected in the film preparation process for the manifestation of the catalytic effect.

交付決定額

		(金額単位:円)	
	直接経費	間接経費	合 計
2010 年度	1, 500, 000	450,000	1,950,000
2011 年度	600,000	180,000	780,000
2012 年度	600,000	180,000	780,000
年度			
年度			
総計	2, 700, 000	810,000	3, 510, 000

研究分野:数物系科学

科研費の分科・細目:プラズマ科学・プラズマ科学 キーワード:インジウム、イオン、触媒化学

1. 研究開始当初の背景

(1)研究代表者は、大阪大学大学院工学研究 科附属原子分子イオン制御理工学センター の「プラズマ粒子制御研究部門」に所属して いた。同センターには、「分子集積技術分野」 という有機合成化学を専門とする講座があ り、本研究は同講座の安田誠准教授(2011年 以降は大阪大学大学院工学研究科応用化学 専攻に所属)を連携研究者として、共同研究 を行ったものである。

(2)研究代表者は連携研究者(安田)から、 インジウムとケイ素の組み合わせが生み出 す全く新しい触媒に関する情報を得た。この 触媒では、遷移状態においてインジウムとケ

イ素が互いに同時に作用しており、通常は多 段階反応が必要なアルコールを還元して対 応するアルカンを得る反応を直接進行させ るなどの利点がある。このような複数金属種 の生み出す反応場では、本来異種環境の金属 同士が直接または間接に作用しあうことが 期待できる[1]。ただし、こうした触媒は従 来の化学的方法では溶媒中に溶解して合成 され、やや面倒な分液操作や分離操作が必要 であった。また、インジウムは稀少金属であ るにもかかわらず、この方法では使用後の触 媒の回収が困難などの問題があった。本研究 では、研究代表者の持つイオンビーム技術を 活用し、これらの問題点を解消したインジウ ム系固体触媒の開発とその特性評価を行っ た。

2. 研究の目的

本研究課題の最終的な目標は、複合系金属 種の協同的作用に基づいた新規反応触媒の 開発である。複合系金属種を利用すれば、 個々の金属種単体の性質を凌駕する物性を 持つ触媒の創成が期待できる。ただし、異種 金属間の相互作用を評価する基礎を固める には、様々な組み合わせを検討する必要があ る[1]。

以下に述べるように、本研究課題ではその 手始めとしてインジウムとケイ素化合物の 組み合わせについて研究を進めた。その他、 ガリウムまたはビスマスとケイ素化合物の 組み合わせについても検討を行った。ガリウ ムはインジウムと同族元素であることから 選んだ。また、比較のため、族の異なる物質 からビスマスを選んだ。

3. 研究の方法

本研究では、複合系金属種の協同的作用に 基づいた新規反応触媒の開発を試みた。以下 ではインジウム/ケイ素に関する実験結果に 限定して述べることにする[2]。

本実験では、低エネルギー質量分離イオン ビーム照射装置[3-6]を用いた。同装置のイ オン源内部には、スパッタターゲットとして 酸化インジウム(In₂0₃)を取り付けている。 スパッタリングの促進のため、酸化インジウ ムには-500Vのバイアス電圧を印加している。

インジウムイオンビームは、以下に示す手順で生成する。まず、イオン源のアークチャンバ(直径 25mm,長さ 51mm)内にアルゴンガス(約 1sccm)を導入する。アークチャンバ内にセットされた高温(2000℃程度)のタングステンフィラメントにより、アルゴンプラズマを発生させる。このアルゴンプラズマ による酸化インジウムのスパッタリングにより、アークチャンバ内にインジウムイオン が生成される。アークチャンバ内に存在する イオンは、引き出し電極に印加した-15kVの 高電圧により引き出される。扇形質量分離器 を介して不純物イオンが取り除かれ、インジ ウムイオンのみが選択される。こうして得ら れたインジウムイオンビームは、集束された 後に所定のエネルギーに減速され、プロセス チャンバ内に配置された基板に照射される。 また、プロセスチャンバ内には、イオンビー ムの質量・エネルギー分析器(balzers, PPM-421)が設置されている。

本研究では、以下の各実験を行った。まず、 アルゴンプラズマによるスパッタリング時 にイオン源内に存在するイオン種の分析を 行った。次に、PPM-421を用いて、質量分離 後のイオンビームの分析を行い、実際にイン ジウムイオンビームが得られていることを 確認した。また、そのエネルギーを測定した。 こうして得られたインジウムイオンビーム を基板に照射し、その表面分析を行った。最 後に、この基板の触媒効果の評価を行った。

ここで用いた基板は、シリコン基板の表面 を熱酸化することにより Si0₂ 膜(膜厚は約 100nm)にしたもの(以下では、Si0₂/Si 基板 と呼ぶ)であり、これをマニピュレータの基 板ホルダーに固定している。基板ホルダーは、 真空導入端子を介して電流計と接続されて おり、これにより基板に照射された電流量を 測定することができる。インジウムイオンの 照射総量(ドース量)は、イオンビームの電 流量と照射時間から求めることができる。イ オンビーム照射中のプロセスチャンバ内の 真空度は10⁻⁶ Pa 程度である。イオン照射済



Fig. 1 Energy distributions of In ion beams used in this study. Preset bias voltages were (a) 50, (b) 100, (c) 200, and (d) 470 V, and actual peak energies of In ions were (a) 56, (b) 104, (c) 205, and (d) 476 eV, respectively.



Fig. 2 X-ray diffraction (XRD) spectra (θ -2 θ method) obtained from SiO₂/Si substrates with In ion implantation [(a)-(d)] or without it (e). The In ion energies used here were (a) 56, (b) 104, (c) 205, and (d) 476 eV. The doses of In ions on these substrates were 1x10¹⁷ ions/cm². The XRD peaks corresponding to In are observed only in (a)-(c).

みの基板は、プロセスチャンバから取り出し た上で、X線回折法(XRD)とX線光電子分光 法(XPS)を用いて分析し、インジウムイオ ンの照射による基板表面の状態変化を調べ た。

 研究成果 まず、イオン源のアークチャンバ内に存在 するイオン種を分析した。フィラメントに用 いているタングステン(₩)、原料ガスに用い



Fig. 3 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) spectra in the In 3d region for (a) an In implanted SiO₂/Si substrate (ion energy = 476 eV, ion dose = 1×10^{17} ions/cm²) and (b) an In metal.

たアルゴン (Ar⁺と Ar²⁺)、スパッタにより発 生したインジウム(In⁺)と酸素(0⁺)に加えて、 炭素 (C⁺)、窒素 (N⁺) が不純物として存在し ていることが分かった。

次に、イオン源から引き出したイオンを質 量分離し、プロセスチャンバまで導いたイオ ンビームを PPM-421 により分析した。イオン ビームの質量スペクトルを測定した結果、こ のイオンビームがインジウムであることを 確認できた。また、インジウム以外の不純物 イオンは含まれていないことが分かった。

Fig. 1には、PPM-421 で測定したイオンビ ームのエネルギースペクトルを示す。ここで は、(a) 50eV、(b) 100eV、(c) 200eV、(d) 470eV の場合のスペクトルを示している。エネルギ ースペクトルの半値幅は約 5eV と狭く、ほぼ 単色のイオンビームが得られていることが 分かった。

こうして得たインジウムイオンビームを 4枚の Si0₂/Si 基板 (a)-(d) に照射する実験 を行った。基板のサイズは 1cm x 1cm で、ビ ームは直径約 8mm の円形で基板に照射される。 ビームのエネルギーは (a) 50eV、(b) 100eV、 (c) 200eV、(d) 470eV とした。いずれの基板 でもイオンドース量は 1x10¹⁷ 個 cm⁻² とした。 インジウムイオン照射後の基板表面状態

を確認するために、XRD により解析を行った。 Fig. 2 には XRD スペクトルを示す。Fig. 2(a)-(d)は、それぞれ基板(a)-(d)に対応し ている。Fig. 2(a)-(c)には、インジウムの ピークがはっきりと存在している。これは、 この基板の表面が金属インジウムの薄膜で 覆われていることを示している。一方、Fig. 2(d)に示すように、基板(d)ではインジウム のピークは見られなかった。Fig. 2(e)には

(1) OH Ph → Ph	(2) + 0 0 +	In ion energy [eV] dose of In ions [ions/cm ²] conditions	(3) 0 0 +	(4) Ph Ph Ph O Ph	(1) OH Ph Ph
1 mmol	1.2 mmo	PII	PD		(recovery)
		conditions			
	(a)	56 eV, 1x10 ¹⁷ ions/cm ² to l uene, 80 °C, 21 h	0%	0%	100%
	(b)	104 eV, 1x10 ¹⁷ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	0%	0%	98%
	(c)	205 eV, 1x10 ¹⁷ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	0%	0%	100%
	(d)	476 eV, 1x10 ¹⁷ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	6%	38%	56%
	(e)	476 eV, 1x10 ¹⁷ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	(2 substrates) 11%	59%	28%
	(f)	56 eV, 1x10 ¹⁶ ions/cm ² to l uene, 80 °C, 21 h	0%	0%	98%
	(g)	105 eV, 1x10 ¹⁶ ions/cm ² to l uene, 80 °C, 21 h	0%	0%	99%
	(h)	204 eV, 1x10 ¹⁶ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	0%	0%	94%
	(i)	476 eV, 2x10 ¹⁶ ions/cm ² toluene, 80 °C, 10 h	0%	0%	100%
	(j)	105 eV, 1x10 ¹⁸ ions/cm ² to l uene, 80 °C, 21 h	0%	0%	97%
	(k)	204 eV, 1x10 ¹⁸ ions/cm ² toluene, 80 °C, 21 h	0%	0%	97%
	(I)	475 eV, 1x10 ¹⁸ ions/cm ² toluene, 80 °C, 26 h	0%	0%	98%

Fig. 4 Yields of the benzhydrol and acetylacetone reactions in the presence of In injected SiO₂/Si substrates formed under different ion beam conditions (a)-(1).

インジウムを照射していない基板のスペク トルを示した。SiO₂/Si 基板単体では、この 角度範囲に Si または SiO₂に起因する XRD ピ ークがないことを示している。

Fig. 2(d)にはピークは見られないが、本 当にインジウムがないのかどうか調べるた め、基板(d)の表面を XPS で解析した。その 結果を Fig. 3(a)に示す。インジウムに起因 する2つのピークが存在することから、この 基板上では金属インジウムの薄膜は形成さ れていないが、インジウム原子は存在してい ることが分かった。参考として、金属インジ ウムのピークを Fig. 3(b) に示す。 Fig. 3(b) と比較すると、Fig. 3(a)のピークは明らか にエネルギーシフトしており、これは基板 (d) 上のインジウムが3価であることを示し ている。Fig. 2 と Fig. 3 から、基板(d)では 照射したインジウムが基板中に適度に分散 して注入されており、SiO₂/Si 基板中のSi ま たは0と結合を作っていることが分かった。 一方、基板(a)-(c)では、照射したインジウ ムは基板内部に注入されることなく、表面に 堆積して金属薄膜を形成しているものと思 われる。

最後に、インジウムイオンを照射した Si0₂/Si 基板の触媒特性を評価した。Fig. 4(a)-(d)は、基板(a)-(d)に対応している。 測定は、(1)ベンズヒドロールと(2)アセチル アセトンが反応して、(3)反応生成物と(4)ビ スジフェニルメチルエーテルを生成する反 応について行った。Fig. 4に示すように、基 板(a)-(c)では反応生成物は確認されなかっ た。基板(d)では 6%の反応生成物が確認され、 この基板に触媒効果があることが分かった。 Fig. 4(e)に示すように、基板(d)と同じ実験 条件で基板の数を2枚にすると反応率もほ ぼ2倍になった。このように、触媒効果は照 射エネルギーに強く依存することが分かっ た。Fig. 4(f)-(1)に示すように、エネルギ ーだけでなくドース量も変える実験を行っ たが、基板(d)以外には反応が進むケースは なかった。したがって、触媒効果は照射する インジウムのドース量にも強く依存し、今回 の実験で発現したのは 470eV かつ 1x10¹⁷ 個 cm⁻²の場合のみであった。

過去の測定[7]において、金属インジウム 単体にはこの反応の触媒効果がないことが 確かめられている。今回得られた結果とイン ジウムイオンビームの堆積率の測定結果[2] を比較検討したところ、基板(a)-(c)で触媒 効果が現れなかったのは、照射したインジウ ムが基板表面にそのまま堆積し、金属インジ ウム薄膜を形成したためと確認できた。一方、 基板(d)では照射したインジウムは金属薄膜 を形成することなく基板中に注入され、基板 内のケイ素もしくは酸素と結合を作ること によってインジウム原子とケイ素原子が近 接して存在する状態(両者の間に相互作用が 起こりうる状態)になっている可能性がある。 これが、基板(d)で触媒効果が発現した理由 と考えられる。なお、エネルギーが基板(d) と同じ470eVでもドース量が1x10¹⁸個 cm⁻²の 基板では触媒効果が発現しなかった(Fig. 4(1))。表面分析の結果、この基板でも金属 インジウム薄膜の形成が確認された。この基 板では照射イオンエネルギーは適正値であ ったが、イオンドース量が過多であったため 最終的には金属インジウムが基板表面に堆 積し、触媒効果が消滅したものと考えられる。

引用文献 [1] M. Yasuda, private communication. [2] S. Yoshimura, et al., Thin Solid Films **520** (2012) 4894. [3] S. Yoshimura, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 1813. [4] S. Yoshimura, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 8204. [5] S. Yoshimura, et al., J. Appl. Phys. **100** (2006) 096107. [6] S. Yoshimura, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 46 (2007) 1707. [7] S. Yoshimura, *et al.*, Appl. Surf. Sci. **257** (2010) 192. 5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 11 件) [1] <u>S. Yoshimura</u>, K. Ikuse, <u>M. Kiuchi</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Yasuda</u>, A. Baba, S. Hamaguchi, Dependence of catalytic properties of indium implanted SiO_2 thin films on the film-substrate temperature during indium ion implantation, *Nuclear Instruments and Method in Physics Research B* in press. 査読有

[2] <u>吉村智</u>,幾世和将,杉本敏司,村井健介,<u>木内正人</u>,浜口智志,ポリメタクリル酸メチル樹脂の水素プラズマ曝露と低エネルギーアルゴンイオンビームによるエッチング, Journal of the Vacuum Society of Japan 56 (2013) 129-132. 査読有

http://www.vacuum-jp.org

[3] <u>S. Yoshimura, M. Kiuchi</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Yasuda</u>, A. Baba, S. Hamaguchi, Dependence of catalytic properties of indium-implanted SiO₂ thin films on the energy and dose of incident indium ions, *Thin Solid Films* **520** (2012) 4894-4897. 査 読有

doi:10.1016/j.tsf.2012.03.028

[4] <u>S. Yoshimura, M. Kiuchi</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Yasuda</u>, A. Baba, S. Hamaguchi, Low energy metal ion beam production with a modified Freeman-type ion source for development of novel catalysts, *e-Journal* of Surface Science and Nanotechnology 10 (2012) 139-144. 査読有

http://www.ssj.org/ejssnt

[5] <u>S. Yoshimura</u>, K. Hine, <u>M. Kiuchi</u>, J. Hashimoto, M. Terauchi, Y. Honda, M. Nishitani, S. Hamaguchi, Sputtering yields of CaO, SrO, and BaO by monochromatic noble gas ion bombardment, *Japanese Journal of Applied Physics* **51** (2012) 08HB02-1-4. 査読有

dx. doi. org/10. 1143. JJAP. 51. 08HB02

[6] <u>S. Yoshimura</u>, Y. Tsukazaki, <u>M. Kiuchi</u>, S. Sugimoto, S. Hamaguchi, Sputtering yields and surface modification of poly(methyl methacrylate) (PMMA) by low-energy Ar⁺/CF₃⁺ ion bombardment with vacuum ultraviolet (VUV) photon irradiation, *Journal of Physics D: Applied Physics* **45** (2012) 505201-1-10. 査読有 doi:10.1088/0022-3727/45/50/505201

[7] <u>S. Yoshimura</u>, K. Hine, <u>M. Kiuchi</u>, J. Hashimoto, M. Terauchi, Y. Honda, M. Nishitani, S. Hamaguchi, Experimental evaluation of CaO, SrO and BaO sputtering yields by Ne⁺ or Xe⁺ ions, *Journal of Physics D: Applied Physics* **44** (2011) 255203-1-5. 査読有

doi:10.1088/0022-3727/44/25/255203

[8] <u>S. Yoshimura</u>, T. Maekawa, Soft x-ray computer tomography of tokamak plasma in control experiment of locked mode

disruption by electron cyclotron heating, IEEE Transactions on Plasma Science 39 (2011) 3000-3001. 査読有 doi:10.1109/TPS.2011.2131685 [9] S. Yoshimura, K. Hine, M. Kiuchi, Y. Nishimoto, M. Yasuda, Baba, Α. S Hamaguchi, Novel catalysts: indium implanted SiO₂ thin films, Applied Surface Science 257 (2010) 192-196. 查読有 doi:10.1016/j.apsusc.2010.06.063

〔学会発表〕(計 10 件)

[1] <u>吉村智</u>、幾世和将、<u>木内正人</u>、西本能弘、 <u>安田誠</u>、馬場章夫、浜口智志、低エネルギー インジウム照射 SiO₂の触媒効果の基板温度 依存性、*第 60 回応用物理学会春季学術講演* 会、2013.3.28、神奈川工大

[2] <u>S. Yoshimura</u>, K. Ikuse, <u>M. Kiuchi</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Yasuda</u>, A. Baba, S. Hamaguchi, Low energy metal ion beam injection to SiO_2 thin films for development of novel catalysts, *25th International Conference on Atomic Collisions in Solid*, 2012. 10. 24, Kyoto University, Japan

[3] <u>S. Yoshimura, M. Kiuchi</u>, Y. Nishimoto, <u>M. Yasuda</u>, A. Baba, S. Hamaguchi, Low energy mass-selected metal ion beam production with a modified Freeman-type ion source for the development of novel catalysts, *International Symposium on Surface Science and Nanotechnology*, 2011. 11. 11, Tower Hall Funabori, Tokyo, Japan

[4] <u>吉村智、木内正人</u>、西本能弘、<u>安田誠</u>、 馬場章夫、浜口智志、インジウム照射 SiO₂ 基板の触媒効果の入射エネルギー依存性、第 72 回応用物理学会学術講演会、2011.9.1、山 形大学

6. 研究組織

(1)研究代表者 吉村 智 (YOSHIMURA SATORU) 大阪大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:40294029
(2)連携研究者 安田 誠 (YASUDA MAKOTO) 大阪大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:40273601 木内 正人 (KIUCHI MASATO) 独立行政法人産業技術総合研究所・ユビキ タスエネルギー研究部門・主任研究員 研究者番号:50356862